

B28D	石材または石材類似材料の加工（採鉱と採石のための機械及び方法 E21 C）
1/00	他に分類されない石材または石材類似材料，例．レンガ，コンクリート，の加工；そのための機械，装置，工具（宝石類や結晶体の精密加工 B28D5/00；研削または研磨による加工 B24；研削面のドレッシングまたは正常化のための装置または手段 B24B53/00）
1/02	・鋸引きによるもの
1/04	・・旋回鋸歯または円板鋸をもつもの（B28D1/10 が優先）
A	ブレ - ドカバ - に関するもの
B	円板鋸が移動するもの
Z	その他
1/06	・・往復鋸歯をもつもの（B28D1/10 が優先）
1/08	・・無端カッタ - 型の鋸歯をもつもの，例．チェン鋸，帯鋸（B28D1/10 が優先）
1/10	・・測定のための設備をもつもの
1/12	・・加工石材に適した特殊な鋸歯
1/14	・中ぐりまたは穴あけによるもの（ボール盤 B23B；衝撃工具 B25D；地中または岩石の削孔 E21B）[1,7]
1/16	・旋削によるもの
1/18	・フライス削りによるもの，例．フライス削り工具による溝切り
1/20	・平削りによるもの，例．平削り工具による溝切り
1/22	・切断によるもの，例．切開
1/24	・・切断円板によるもの
1/26	・衝撃工具によるもの，例．たがねまたは切断刃を有する他の工具（可搬式衝撃工具 B25D）
1/28	・・切断刃を有しないもの
1/30	・使用された作業方法にかかわらず輪郭，すなわち曲面，を形成するためのもの（美術的目的のもの B44B）
1/32	・容易に碎かれやすい材料の加工に適した方法および装置，例．雲母，粘板岩，片岩
3/00	粉碎円板またはロ - ラ - の仕上げ（鋸盤またはその装置の工具の仕上げ B23D63/00；切断を容易にするための切断機の刃部の処理 B26D7/08）
3/02	・機械
3/04	・・ロ - ラに溝を付けるためのもの
5/00	宝石類，結晶体の精密加工，例．半導体の材料；そのための装置（研磨またはつや出しによる加工 B24；美術的目的のもの B44B；機械的方法によらないもの C04B41/00；単結晶の機械的でない後処理 C30B33/00）[3]
A	半導体ウエハの折曲切断
Z	その他
5/02	・回転工具によるもの，例．ドリル
A	半導体の加工
B	・インゴットのスライス
C	・・内周刃工具によるもの
D	・・・工具の取付
E	・・・工具の送り（F が優先）
F	・・・工具の反り防止
G	・・・ワ - クの取扱い、送り
Z	その他

5/04	・回転式以外の工具によるもの，例．往復動工具
A	半導体の加工
B	・インゴットのスライス
C	・・ワイヤ - 工具によるもの
D	・・ブレ - ド工具によるもの
Z	その他
7/00	このサブクラスの他のグループに属した機械器具の使用に適した特殊補助具
7/02	・ちりを除いたりまたは鎮めたりするもの，例．液をスプレ - することによるもの；工作物を冷却するためのもの
7/04	・工作物を支持または保持するためのもの

